

中信证券股份有限公司
关于
重庆臻宝科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之
上市保荐书

保荐人（主承销商）



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二五年六月

目 录

目 录.....	1
声 明.....	2
第一节 本次证券发行基本情况	3
一、发行人基本情况.....	3
二、本次发行情况.....	16
三、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况.....	17
四、保荐人与发行人的关联关系.....	18
五、保荐人内部审核程序和内核意见.....	19
第二节 保荐人承诺事项	21
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐意见	22
一、保荐意见.....	22
二、本次发行履行了必要的决策程序.....	22
三、发行人符合科创板定位和国家产业政策.....	23
四、发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件	25
五、对公司持续督导期间的工作安排.....	27

声 明

中信证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义）

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

发行人名称：重庆臻宝科技股份有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 56 号

注册时间：2016 年 2 月 25 日（股份公司成立日期 2023 年 1 月 5 日）

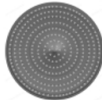
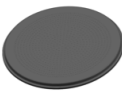
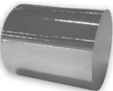
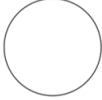
联系方式：023-6863 6693

本次证券发行类型：首次公开发行股票并在科创板上市

（二）发行人的主营业务

公司专注于为集成电路及显示面板行业客户提供制造设备真空腔体内参与工艺反应的零部件及其表面处理解决方案。公司主要产品为硅、石英、碳化硅和氧化铝陶瓷等设备零部件产品，以及熔射再生、阳极氧化和精密清洗等表面处理服务。公司零部件产品和表面处理服务主要应用于集成电路行业等离子体刻蚀、薄膜沉积等工艺的半导体设备和显示面板行业等离子体刻蚀、薄膜沉积和蒸镀等工艺的面板制造设备。公司已量产大直径单晶硅棒、多晶硅棒、化学气相沉积高纯碳化硅超厚材料和陶瓷造粒粉体等半导体材料，形成“原材料+零部件+表面处理”一体化业务平台，并不断突破关键半导体材料制备技术和表面处理技术、拓展核心零部件产品品类，向客户提供制造设备真空腔体内多品类零部件整体解决方案。

图：“原材料+零部件”业务矩阵

类别	代表性零部件产品			代表性原材料	
硅					
	曲面硅上部电极	硅上部电极	硅环	大直径单晶硅棒	多晶硅棒
石英					
	石英环	石英气体分配盘	石英盘	石英喷嘴	石英窗
陶瓷					
	静电卡盘	陶瓷板	陶瓷杆	陶瓷筒	氧化铝陶瓷造粒粉
碳化硅					
	聚焦环	支撑环	嵌入环	接地环	化学气相沉积碳化硅

注：上图仅列示公司部分代表性产品

设备零部件是集成电路和显示面板制造产业不可或缺的基础关键支撑，零部件的性能、质量和精度直接决定了生产设备的可靠性和稳定性，集成电路和显示面板制造设备零部件的本土化供应成为主要的“卡脖子”突破口。公司紧扣国家产业政策和科技创新发展战略，深耕设备零部件领域，已与国内主要集成电路制造厂商和显示面板制造厂商建立了长期稳定的合作关系，助力客户制造工艺与设备零部件升级。公司业务已覆盖国内主流存储芯片制造厂商和国内主流集成电路制造厂商，京东方、华星光电、天马微电子、惠科股份和彩虹光电等国内主流显示面板厂商，通过零部件国产替代保障先进制程产线的供应链安全。同时，公司已进入英特尔（大连）、格罗方德、联华电子和德州仪器等国际集成电路制造厂商供应链，具备一定的国际竞争力。

零部件产品方面，公司已量产曲面硅上部电极、石英气体分配盘、高纯碳化硅环等核心零部件产品，并批量供应于逻辑类 14nm 及以下技术节点先进工艺集成电路制造、存储类 200 层及以上堆叠先进工艺 3D NAND 闪存芯片制造、20nm 及以下技术节点 DRAM 先进工艺存储芯片制造等领域，处于国内领先地位；并已在显示面板领域实现 G10.5-G11 超大世代、4.5KV-5KV 超高压工艺和 OLED 工艺制造设备中的静电卡盘以及 PVD 设备中的双极静电卡盘等关键零部件的国产替代。

原材料制造方面，公司已量产用于硅零部件生产的大直径单晶硅棒、用于高纯碳化硅零部件生产的化学气相沉积碳化硅材料和用于陶瓷零部件生产的氧化铝、氧化钼陶瓷造粒粉，持续推进高致密陶瓷涂层制备工艺的迭代开发。公司原材料的自主生产提升了产品质量和客制化零部件的研发生产能力，保障了公司供应链的稳定。

表面处理方面，在集成电路制造领域，公司表面处理服务已供应于逻辑类 14nm 及以下技术节点先进工艺集成电路制造和存储类 200 层及以上堆叠先进工艺 3D NAND 闪存芯片制造。在显示面板领域，公司表面处理服务已供应于 G10.5-G11 超大世代和 AMOLED 等显示面板高端工艺产线。

公司具备坚实的研发能力，在硅、碳化硅等半导体材料的制备环节，形成了大直径单晶硅棒拉制和碳化硅气相沉积等关键材料制备技术；在硅、石英、陶瓷和碳化硅等硬脆半导体材料的高精密加工环节，形成了微深孔精密制造、曲面精加工和微深孔刻蚀等精密加工技术；在精密清洗、阳极氧化和熔射再生等表面处理环节，阶段性突破了高致密涂层制备等表面处理技术，形成了“原材料+零部件+表面处理”一体化业务平台。公司还自主开发了加工刻蚀液、加工工具和装置，是国内少数实现集成电路先进制程设备和高世代、高电压显示面板制造设备非金属零部件多品类供应、规模化量产的企业之一。

公司系国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、重庆市先进智能工厂、重庆博士后工作站、重庆市技术创新示范企业和重庆市企业技术中心。报告期内，公司积极牵头承担国家发改委重大技术装备攻关专项项目，协助行业龙头客户推进重点攻关项目国产化研发，助力国产供应链体系的完善和自主可控，保障集成电路制造行业的稳定可持续发展。公司已建立较为完整的知识产权体系，截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有 113 名研发人员和 105 项专利，其中发明专利 51 项，在申请发明专利 38 项。

（三）发行人的核心技术及研发水平

截至本上市保荐书签署日，公司掌握的主要核心技术情况如下：

公司主要产品	核心指标	指标释义	公司与中国大陆地区竞争对手比较	公司与全球竞争对手对比较	对应全球范围内主要厂商
硅零部件	平面度	平面度是评定零部件表面质量的关键指标之一，指标越小，精度和性能越高	一致	一致	三菱材料、SK Enpulse、Hana、Silfex、盾源聚芯等
	粗糙度	粗糙度是指加工表面微小的峰谷之间的距离，指标越小，表面越光滑	一致	一致	
	单孔偏差	实际微孔直径与标准直径间的差距，单孔偏差越小，硅部件的打孔技术越好	优于	略低于	
	微孔直径	硅气体分配盘表面分布有上百个微孔，用于反应气体通过微孔均匀进入反应腔体内，微孔直径越小，机械点啄打孔技术越好	可比口径披露数据较少	一致	
	微孔深径比	机械点啄打孔技术下，微孔深度与直径的比例越大，加工难度越高，孔径内部处理难度越大	优于	优于	
石英零部件	平面度	平面度是评定零部件表面质量的关键指标之一，指标越小，精度和性能越高	可比口径披露数据较少	一致	Ferrotec、贺利氏等
	粗糙度	粗糙度是指加工表面微小的峰谷之间的距离，指标越小，表面越光滑	可比口径披露数据较少	一致	
	火加工形变量	火加工形变量是指氢氧焰高温熔化石英材料退火后的尺寸变化量，尺寸变化数值越小，火加工技术要求越高	国内火加工石英零部件企业较少	一致	
	火加工光洁度	火加工光洁度是指用氢氧焰高温熔化石英材料后的表面粗糙度，光洁度指标越小，火加工技术要求越高		优于	
陶瓷零部件	密度	致密性指标，指标越大，性能越优	优于	一致	京瓷集团、CoorsTek、NGK等
	机械强度	将挤压断裂时的最大应力除以试样横截面积得到机械强度，指标越大，性能越优	一致	一致	
	酸碱腐蚀速率	单位时间的腐蚀程度平均值，指标越小，耐酸碱腐蚀性越强	一致	一致	
精密清洗	颗粒物数量（particle）	颗粒物数量（particle）是影响半导体器件制造质量的重要因素，能反映零部件的固体颗粒污染物情况的指标，颗粒数越少，受污染程度越低	一致	一致	KoMiCo、西诺斯、世禾科技、科秉电子、富乐德等
	部件损耗量	零部件清洗过程中的损耗情况，指标越小，部件损耗量越小	一致	一致	

公司主要产品	核心指标	指标释义	公司与中国大陆地区竞争对手比较	公司与全球竞争对手对比较	对应全球范围内主要厂商
阳极氧化	扩孔率	产品进行阳极氧化处理后，该制备工艺对产品微孔的损耗度，微孔扩孔率指标越小，阳极氧化处理性能越好	可比口径公开信息较少	一致	珂玛科技、富乐德等
熔射再生	耐电压性	能够承受的最高电压值，指标越大，耐压性能越好	优于	一致	
	孔隙率	多孔物体的孔隙体积和总体积之比，孔隙率越小，致密性越好	一致	略低于	
熔射再生、阳极氧化和精密清洗业务综合解决方案能力		表面处理服务能力越多，提供综合解决方案能力越强	少数企业具备	少数企业具备	珂玛科技、富乐德等

资料来源：企业官网、公告文件、弗若斯特沙利文
注：中国大陆地区/本土竞争对手不包含母公司注册在境外的企业

（四）发行人在报告期内的主要经营和财务数据及指标

项目	2024 年度/ 2024.12.31	2023 年度/ 2023.12.31	2022 年度/ 2022.12.31
资产总额（万元）	126,898.76	102,147.84	55,233.12
归属于母公司所有者权益（万元）	96,921.08	80,964.38	30,141.40
资产负债率（母公司）	17.51	17.33	42.21
营业收入（万元）	63,450.10	50,635.63	38,561.04
净利润（万元）	15,191.09	10,780.52	8,162.16
归属于母公司所有者的净利润（万元）	15,191.09	10,780.52	8,162.16
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	14,519.67	10,351.74	7,786.62
基本每股收益（元）	1.30	1.06	0.86
稀释每股收益（元）	1.30	1.06	0.86
加权平均净资产收益率	17.10	24.46	28.92
经营活动产生的现金流量净额（万元）	20,631.92	7,769.80	9,322.21
现金分红（万元）	-	-	4,250.00
研发投入占营业收入比例	8.36	5.91	4.72

注：2022 年度，根据股东会审议通过的 2021 年利润分配方案，公司向各股东分配现金股利合计人民币 4,250.00 万元；2022 年度，根据上海升芯股东会决议，上海升芯在被收购前向原有股东分配了 2022 年 1-5 月实现的净利润 267.07 万元

（五）发行人的主要风险

1、与发行人相关的风险

（1）技术风险

1) 无法跟随技术升级迭代的风险

半导体及显示面板设备零部件行业属于技术密集型行业，芯片制程和显示面板技术在不断升级，且集成电路和显示面板制造企业也在不断提升工艺效率及产品良率，公司必须紧跟集成电路和显示面板制造企业的需求，不断提高工艺水平以及产品性能。若公司产品研发不能及时满足客户需求，不能紧跟客户产品的更新迭代，则公司的行业地位和未来经营业绩将受到不利影响。

2) 技术人才流失与核心技术泄密的风险

随着市场需求的不断增长与行业竞争的日益激烈，半导体及显示面板设备零

部件行业对技术人才的需求不断提升，公司需长期维持技术人才充足、队伍稳定以保持市场竞争力。若无法持续为技术人才提供更具竞争力的薪酬待遇和发展平台，公司将面临技术人才流失的风险。

同时，随着半导体和显示面板行业技术壁垒的不断提高，核心技术对于公司保持和提升竞争力至关重要。自成立以来，公司高度重视对核心技术的保护，但仍不排除因技术人才流失、员工工作疏漏、外界窃取等原因导致核心技术泄密的风险，进而导致公司竞争力下降。

(2) 经营风险

1) 客户集中度较高的风险

报告期内，公司向前五大客户的销售收入占比分别为 80.23%、74.59%和 72.80%，呈逐年下降趋势，但客户集中度仍较高，主要原因为半导体和显示面板行业的技术和资本密集度较高，下游集成电路制造和显示面板制造企业呈现数量少、规模大的特征。若公司主要客户生产经营情况出现恶化、或由于半导体和显示面板行业景气度下降导致客户资本性支出和产能利用率下降，进而导致其向公司下达的订单量下降，则可能对公司的业绩稳定性产生影响。此外，如果公司无法维护与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新客户并转化为收入，亦可能对公司经营业绩产生不利影响。

2) 新产品开发及客户验证不及预期的风险

公司新产品需要在晶圆厂上机验证，验证通过后方可获得晶圆厂订单。若公司新产品开发不及预期、或新产品在晶圆厂客户验证不及预期，导致公司新产品未能获得足够的晶圆厂订单，均可能对公司持续经营产生不利影响。

3) 生产经营合规风险

公司阳极氧化业务涉及硫酸等多种危险化学品的购买及使用，对生产人员的规范操作和技术水平要求较高。同时，表面处理环节还会产生多种含铝、氟化物等成分的废水、粉尘及固体废弃物。报告期内，公司严格遵守国家及所在地方的环保和安全生产法律法规进行生产，按照法律法规和地方政府的相关要求对污染物处理后进行排放。若公司由于污染物排放不达标造成环境污染，或在生产经营中出现安全事故，可能受到相关部门的行政处罚，对公司生产经营造成不利影响。

4) 经营场所租赁的风险

报告期内，公司的生产经营场所主要通过租赁方式取得。虽然公司已签署了长期的租赁协议，对租赁场所拥有优先租赁权、优先购买权，对经营场所的租赁处于持续稳定状态，但不排除出现租赁合同不能继续履行、到期无法续租或租金大幅上涨、租赁过程中发生出租方违约等情形。如果发生上述情形，则公司可能因需要搬迁而产生额外费用，在短期内亦可能会影响公司正常经营。

截至本上市保荐书签署日，重庆芯洁承租并实际使用的第三层标准厂房租赁合同已到期，由于出租方内部续签租赁协议审核的周期较长，出租方暂未完成租赁合同的续签，目前重庆芯洁仍继续使用上述租赁房屋。若因出租方内部审批流程或其他因素导致出租方解除租赁合同，重庆芯洁可能面临无法继续使用该租赁房产的风险。

5) 知识产权风险

公司所处的半导体和显示面板行业为技术密集型行业，知识产权及技术 Know-How 保护对公司的发展至关重要。截至 2024 年 12 月 31 日，公司拥有 105 项专利，其中 51 项发明专利，申请中发明专利 38 项。如未来公司的知识产权及技术 Know-How 被他人不当利用，或出现泄密，或发生知识产权纠纷，则公司可能因此承担一定的法律和经营风险，从而对公司的研发、生产产生一定的影响，并影响公司的正常经营。

6) 经营规模扩大带来的管理风险

报告期内，随着公司业务不断发展，公司收入规模、资产规模持续扩张，相应将在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、内部控制等方面对管理人员提出更高的要求，公司在战略规划、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战，对研发、采购、生产、销售等资源配置提出了更高的要求。如果公司的组织模式和管理制度未能随着公司规模扩张及时调整完善，管理水平无法适应公司的快速发展，将使公司在一定程度上面临规模扩张导致的管理风险，对未来业务的发展造成不利影响。

7) 实际控制人及其一致行动人不当控制的风险

本次发行前，公司实际控制人王兵直接持有公司 5,162.50 万股股份，占公司

股本总额的 44.33%，并通过重庆臻芯合伙、重庆臻宝合伙控制公司 12.88% 的股份。夏冰为王兵配偶，直接持有公司 3.01% 的股份，并通过员工持股平台重庆臻芯合伙间接持有公司 1.80% 的股份，王喜才为王兵哥哥，直接持有公司 0.24% 的股份，王凤英为王兵姐姐，通过重庆臻芯合伙间接持有公司 1.85% 的股份，前述三人为公司实际控制人王兵的一致行动人。假设本次公开发行股份 3,882.26 万股，本次发行完成后，王兵及其一致行动人合计控制公司的表决权比例为 45.34%，仍可凭借其控制地位，通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策等进行控制，如果控制不当将会损害公司及公司其他股东的利益。

8) 租赁物业存在产权瑕疵或租赁合同未备案的风险

公司租赁物业中，由于施工方施工方案变更的原因，实际建造时一处污水处理站、一处污水处理池及一处生产厂房增加了部分面积，上述未按照施工方案施工的不动产暂时无法办理不动产产权证明。公司在签署租赁协议时，亦未明确在租赁合同中约定承租上述不动产，但在生产经营中实际会使用部分污水处理设备，亦会使用厂房作为设备间。此外，公司及附属公司部分非用作主要经营场所的不动产未办理租赁备案。

如若将来公司租赁的瑕疵房产被有权机构要求拆除、搬迁或因租赁合同未备案导致无法续租，则会对公司的正常经营产生一定的影响。

9) 产品与服务质量风险

由于集成电路及显示面板制造设备零部件及其表面处理技术的高度复杂性，公司及客户的检测程序可能无法完全识别潜在质量问题。若客户在使用过程中发现缺陷，可能导致客户产生经济损失，进而引发诉讼或赔偿。此外，质量问题可能损害公司声誉，导致客户流失及市场拓展受阻。如若公司服务出现上述质量问题，将可能对公司的经营业绩和市场声誉产生不利影响。

10) 验收时间不可控的风险

公司完成显示面板设备零部件的表面处理并送到客户现场后，何时上机运行并获得客户验收确认主要受客户的生产计划、设备保养周期、备品备件情况等多种因素影响，从设备部件送达到验收确认的间隔期限变动较大，且不受公司控制。如果客户的上机验收周期延长，公司的收入确认时间也将有所延迟；同时，公司

可能存在上机验收不通过、收款时间延后和存货规模提升等风险，可能会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

11) 部分原材料采购自境外的风险

公司生产所需的原材料主要包括硅材料、石英材料、碳化硅材料、陶瓷材料、熔射粉和工程塑料等，其中报告期内陶瓷、工程塑料、碳化硅等部分原材料及零部件存在向境外供应商采购的情况。虽然公司已与相关供应商建立了长期、稳定的合作关系，但若未来出现地缘政治动荡、全球贸易摩擦及其他不可抗力，公司境外采购可能出现交货延迟、供应受限或成本上涨的情况，则公司正常生产经营可能会受到不利影响。

(3) 财务风险

1) 应收账款回收的风险

报告期各期末，公司应收账款余额分别为 13,107.06 万元、18,257.43 万元和 22,326.01 万元，占当期营业收入的比例分别为 33.99%、36.06%和 35.19%。未来，公司应收账款金额或将随着公司经营规模的进一步扩大而增加，存在应收账款周转率下降、营运资金占用增加的风险。如果未来公司应收账款回款情况不理想或主要客户自身发生重大经营困难而导致公司无法及时收回货款，将对公司生产经营产生不利影响。

2) 存货跌价风险

公司存货由原材料、在产品、库存商品、低值易耗品及发出商品组成，其中以原材料、库存商品、发出商品为主。报告期各期末，公司存货账面价值分别为 8,343.80 万元、10,051.10 万元和 11,664.94 万元，占流动资产的比例分别为 35.16%、16.30%和 15.73%，公司存货规模呈现逐年增长的趋势。如果未来行业供需关系、产品销售价格等发生重大不利变化，公司可能面临存货跌价风险，进而影响公司的盈利水平。

3) 毛利率波动风险

报告期内，公司综合毛利率分别为 43.37%、42.56%和 48.05%，其中半导体行业产品毛利率分别为 50.93%、54.16%和 56.79%，显示面板行业产品毛利率分

别为 33.00%、23.06%和 25.34%。如果未来行业竞争加剧、下游市场需求减少、产品价格下降和原材料价格上涨，或公司无法有效控制产品成本，可能导致公司毛利率波动，从而影响公司的盈利能力及业绩表现。

4) 税收优惠风险

报告期内，公司享受高新技术企业所得税和研发费用加计扣除的税收优惠；重庆芯洁、臻宝半导体符合西部地区鼓励类产业目录界定的产业范围，享受西部大开发企业所得税优惠政策；上海臻宝、湖北芯洁 2022-2024 年度属于小型微利企业，享受小微企业所得税优惠政策；上海升芯 2023-2024 年度属于小型微利企业，享受小微企业所得税优惠政策。若未来公司或子公司无法继续取得高新技术企业资质、不再符合西部地区鼓励类产业企业税收优惠条件或小型微利企业所得税优惠政策，或者相关优惠政策发生变化，则可能导致公司或子公司无法继续享受相关税收优惠政策，将对公司的经营业绩产生不利影响。

(4) 募集资金投资项目风险

1) 募投项目未能按期完成或不能达到预期收益的风险

本次募投项目涉及现有产能扩建、新产品拓展和技术研发等内容，对公司的技术、组织和管理提出了较高的要求。本次募投项目主要以当前国家政策导向和市场发展趋势为基础，结合公司目前业务经验积累的研发技术而做出，然而随着半导体及显示面板设备零部件行业的快速发展，公司可能面临来自市场变化、技术革新和运营管理等多方面的挑战，如若公司处理不当，募投项目存在不能按期完成或不能达到预期收益的风险。

2) 新增固定资产折旧和摊销影响盈利能力风险

本次发行的募集资金投资项目实施后公司将新增固定资产投资 102,051.69 万元，预计稳定达产后每年新增折旧摊销费用峰值达 7,397.18 万元，在稳定达产前将导致公司生产成本和费用增加。如因市场环境变化或公司经营管理不善等原因导致募集资金投资项目投产后不能如期产生收益或盈利水平不及预期，新增生产成本和费用将大幅提升公司经营风险，对公司经营业绩产生不利影响。

3) 募投项目新增产能的消化风险

报告期内，公司总体产品的产能利用率分别为 93.88%、97.49%和 103.79%。公司本次发行募集资金拟运用于半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目、上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目、臻宝科技研发中心建设项目和补充流动资金。

上述项目新增生产规模结合了公司对半导体及泛半导体精密零部件及上下游领域开拓情况的预估，尽管公司本次募集资金投向系经过充分的可行性论证和 market 分析而确定，但如果未来市场需求发生重大不利变化，或公司对新市场开拓不力，将有可能导致订单需求不足，进而导致部分生产设备闲置、人员冗余，公司存在产能不能及时消化的风险。

2、与行业相关的风险

(1) 市场竞争加剧导致产品价格和盈利能力下降风险

随着全球半导体和显示面板行业的快速发展，半导体和显示面板设备零部件的需求不断增加，吸引了越来越多的市场参与者。新加入者通过跨行新设、并购重组和上游原材料企业往下延伸等方式参与该市场。

目前，半导体和显示面板设备零部件市场主要由美国、日本、韩国等境外同行业公司占据主导地位。公司与境外同行业公司在技术实力、产业规模和品牌声誉等方面仍然存在一定的差距。同时，随着半导体和显示面板设备零部件领域国产替代进程的不断加速，未来将有更多国产零部件厂商加入市场竞争。如果公司未来无法持续提升研发实力、产品性能和客户服务能力以应对日益激烈的市场竞争，将导致公司产品的市场竞争力下降，从而对公司的盈利能力产生不利影响。

(2) 半导体行业被美国等发达国家进一步制裁的风险

近年来，随着美国芯片法案等贸易限制政策不断加码，地缘政治不确定性持续加剧，全球半导体供应链不稳定性显著提升，集成电路行业已逐步成为中美技术竞争的焦点。公司主要从事设备零部件制造及表面处理服务，主要客户为国内集成电路制造企业。如果未来相关国家和地区出于贸易保护、地缘政治等原因，采取限制国内晶圆厂购买先进半导体设备、停止关键设备维修保养服务或者停供需定期更换的“卡脖子”设备零部件等措施，国内先进制程芯片的稳定生产、工

艺升级及产能扩张将受到影响。公司半导体行业主要客户是国内先进制程集成电路制造企业，则公司也可能面临下游终端订单需求下降等风险，从而对公司经营发展产生一定的不利影响。

（3）产业政策变化风险

公司是一家专业从事半导体及显示面板设备零部件及材料的研发、生产与销售的高新技术企业，下游客户是集成电路和显示面板制造企业。发行人业务发展情况与半导体及显示面板制造行业的发展情况紧密相关，而该等行业的发展及国产化的推进受国家政策和财政补贴因素影响较大。若未来国家对于半导体及显示面板制造行业不能持续出台相关政策，将可能对公司业绩产生不利影响。

（4）主要原材料价格波动风险

公司采购的主要原材料包括硅材料、石英材料、碳化硅材料、陶瓷材料、熔射粉和工程塑料等，以及辅料辅材。原材料价格的波动直接影响公司产品的成本及毛利率水平。公司生产所需的上述原材料虽然具有稳定的来源，但价格容易受到宏观环境、经济周期、市场需求和汇率等因素的影响出现较大波动。未来若原材料市场价格持续出现大幅上涨，或公司难以将原材料价格上涨传导至客户端，可能导致公司营业成本上升，对公司业绩产生不利影响。

（5）宏观经济及行业波动风险

公司的产品主要应用于集成电路和显示面板制造行业，下游行业景气度与宏观经济周期存在一定的关联性，客户对公司的产品需求亦直接受到集成电路、显示面板制造及终端应用市场的影响。在宏观经济形势向好时，消费及投资活动上升，集成电路和显示面板的市场需求增加，带动下游客户产销量增加，公司产品需求增加；在宏观经济形势低迷时，消费者购买力下降，投资活动减少，集成电路和显示面板的市场需求减少，从而使下游客户产销量相应减少，公司产品需求减少。

如果未来宏观经济发生剧烈波动，导致人工智能、5G 通信、计算机、消费电子、网络通信、汽车电子和物联网领域等终端市场需求下降，集成电路制造企业产能将过剩，产能利用率下降，从而影响客户对公司产品的需求，对公司的业务发展和经营业绩造成不利影响。

（6）国际贸易政策风险

报告期内，公司部分产品销往海外，主要出口地区包括新加坡、泰国、日本等；公司主要显示面板类客户的下游销售覆盖美洲、欧洲等市场。各国政治经济变动可能引发贸易政策调整，如美国宣布自 2025 年 2 月起分阶段实施关税加征政策，并在 4 月进一步上调部分中国商品的进口关税。若国际贸易环境持续恶化，公司及客户可能面临关税成本上升而无法完全转嫁的风险，终端客户的采购意愿也可能因成本增加而降低，公司及客户的出口利润率可能受到挤压；若客户因成本压力削减订单，将对公司业绩造成不利影响。

3、其他风险

（1）发行失败风险

公司本次申请首次公开发行股票并在科创板上市，发行结果将受到公开发行时国内外宏观经济环境、证券市场整体情况、投资者对公司股票发行价格的认可程度及股价未来趋势判断等多种内、外部因素的影响，可能存在因认购不足而导致的发行失败风险。同时，在中国证监会同意注册决定的有效期内，按照市场化询价结果确定的发行价格，可能存在因公司预计发行后总市值不满足在本上市保荐书中明确选择的市值与财务指标上市标准，而导致发行失败的风险。

（2）前瞻性陈述可能不准确的风险

本上市保荐书刊载有若干前瞻性陈述，涉及公司未来发展规划、业务发展目标、盈利能力等方面的预期或相关的讨论。尽管公司相信，该等预期或讨论所依据的假设是审慎、合理的，但亦提醒投资者注意，该等预期或讨论涉及的风险和不确定性可能不准确。

二、本次发行情况

发行股票种类：	人民币普通股（A）股
发行股数，股东公开发售股数：	本次拟发行股份不超过 3,882.26 万股（含 3,882.26 万股，且不低于本次发行后公司总股本的 25%，以中国证监会同意注册后的数量为准），公司股东不公开发售股份
发行方式：	本次发行将采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的发行方式或者中国证监会等监管机构认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。本次申请首次公开发行股票可以选择采用超额配售选择权，采用超额配售选

	择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的 15%
每股面值：	人民币 1.00 元
每股发行价格：	【】元
预计发行日期：	【】年【】月【】日
拟上市的交易所和板块：	上海证券交易所科创板
发行后总股本：	不超过 15,529.03 万股
保荐人（主承销商）：	中信证券股份有限公司

三、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况

中信证券指定杨腾、韩潇为重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人；指定栾承昊为项目协办人，指定宋建洪、欧阳旭峰、买鸿翔、洪卉中、张鹏飞为项目组成员。

（一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况

杨腾，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会信息传媒行业组高级副总裁。曾参与或负责了中国移动 IPO、易点天下 IPO、英利汽车 IPO 和再融资、圣邦股份 IPO、朗科智能 IPO 和大博医疗 IPO 等项目。其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

韩潇，女，保荐代表人，CFA、FRM，现任中信证券投资银行管理委员会信息传媒行业组副总裁。曾负责或参与了振华风光 IPO、誉帆科技 IPO 等项目及多家企业的改制辅导、投融资等工作。其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）项目协办人

栾承昊，男，注册会计师，现任中信证券投资银行管理委员会信息传媒行业组高级副总裁。曾负责或参与了朗新科技 IPO、华如科技 IPO、睿创微纳 IPO、英利汽车 IPO、东杰智能 IPO、博纳影业 IPO 等项目工作。其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（三）项目组其他成员情况

项目组其他成员包括：宋建洪、欧阳旭峰、买鸿翔、洪卉中、张鹏飞。

（四）本次证券发行上市的项目人员联系方式

本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层

联系电话：010-60834526

四、保荐人与发行人的关联关系

（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

截至本上市保荐书签署日，中证投资直接持有发行人 131.11 万股（对应发行前持股比例为 1.13%）。中证投资系本次发行的保荐人和主承销商中信证券的全资子公司，通过发行人股东长存基金、上海浦宸间接持有发行人合计不超过 0.06% 的股份。除上述持股外，保荐人及其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人及其控股股东、重要关联方股份情况。保荐人将根据科创板规则实施跟投，由保荐人或符合规定之关联公司或主体参与本次发行的跟投，后续将按上交所相关规定进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。

除前述情况外，截至本上市保荐书签署日，保荐人及其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况

除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，截至本上市保荐书签署日，发行人或其控股股东、重要关联方未持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份。

（三）本保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况

截至本上市保荐书签署日，本保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、

高级管理人员不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况，也不存在在发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方处任职的情况。

（四）本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况

截至本上市保荐书签署日，本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。

（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系

截至本上市保荐书签署日，本保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

五、保荐人内部审核程序和内核意见

（一）内核程序

中信证券设内核部，负责本机构投资银行类项目的内核工作。本保荐人内部审核具体程序如下：

首先，由内核部按照项目所处阶段及项目组的预约对项目进行现场审核。内核部在受理申请文件之后，由两名专职审核人员分别从法律和财务的角度对项目申请文件进行初审，同时内核部还外聘律师及会计师分别从各自的专业角度对项目申请文件进行审核。审核人员将依据初审情况和外聘律师及会计师的意见向项目组出具审核反馈意见。

其次，内核部将根据项目进度召集和主持内核会议审议项目发行申报申请，审核人员将把项目审核过程中发现的主要问题形成书面报告在内核会上报告给参会委员；同时保荐代表人和项目组需要对问题及其解决措施或落实情况向委员进行解释和说明。在对主要问题进行充分讨论的基础上，由内核委员投票表决决定项目发行申报申请是否通过内核委员会的审核。内核会后，内核部将向项目组出具综合内核会各位委员的意见形成的内核会反馈意见，并由项目组进行答复和落实。

最后，内核部还将对持续督导期间项目组报送的相关文件进行审核，并关注发行人在持续督导期间出现的重大异常情况。

（二）内部核查意见

2025年5月15日,中信证券通过线下形式召开了臻宝科技IPO项目内核会,对该项目申请进行了讨论,经全体参会内核委员投票表决,该项目通过了中信证券内核委员会的审议,同意将重庆臻宝科技股份有限公司的申请文件上报监管机构审核。

第二节 保荐人承诺事项

一、保荐人已按照法律法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

本保荐人同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本上市保荐书，相关结论具备相应的保荐工作底稿支持。

二、保荐人对发行人申请文件、证券发行募集文件中有证券服务机构及其签字人员出具专业意见的内容，已结合尽职调查过程中获得的信息对其进行审慎核查，并对发行人提供的资料和披露的内容进行独立判断。保荐人所作的判断与证券服务机构的专业意见不存在重大差异的。

三、保荐人有充分理由确信发行人已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序。

四、保荐人有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、保荐人保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、保荐人保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的相关规定以及行业规范。

七、保荐人自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法(2025修正)》采取的监管措施，并接受上海证券交易所的自律监管。

八、若因保荐人为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成经济损失的，将依法赔偿投资者损失。

第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐意见

一、保荐意见

本保荐人根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 修正）》《首次公开发行股票注册管理办法（2023 修订）》《保荐人尽职调查工作准则（2022 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题的意见》（证监会公告[2012]14 号）等法规的规定，由项目组对发行人进行了充分的尽职调查，由内核会议进行了集体评审，认为：发行人具备《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法（2023 修订）》和《科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的首次公开发行股票并在科创板上市的条件。发行人具有自主创新能力和成长性，法人治理结构健全，经营运作规范；发行人主营业务突出，发展前景良好；本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合发行人的经营发展战略，能够产生良好的经济效益，有利于推动发行人持续稳定发展。因此，本保荐人同意对发行人首次公开发行股票并在科创板上市予以保荐。

二、本次发行履行了必要的决策程序

（一）董事会决策程序

2025 年 3 月 18 日，发行人召开了第一届董事会第十一次会议，全体董事出席会议，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》等相关议案。

（二）股东大会决策程序

2025 年 4 月 3 日，发行人召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》等相关议案。

综上，本保荐人认为，发行人本次发行已获得了必要的批准和授权，履行了必要的决策程序，决策程序合法有效。

三、发行人符合科创板定位和国家产业政策

（一）公司符合科创板定位要求的具体情况及依据

公司符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024年4月修订）》等有关规定对行业领域及对科创属性相关指标的要求，主要包括：

1、公司符合行业领域要求

公司所属行业领域	☒ 新一代信息技术	根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”（代码：C39）下的“电子专用材料制造”（代码：C3985）； 根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业领域属于“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.3 高储能和关键电子材料制造”
	☐ 高端装备	
	☐ 新材料	
	☐ 新能源	
	☐ 节能环保	
	☐ 生物医药	
	☐ 符合科创板定位的其他领域	

2、公司符合科创属性要求

科创属性评价标准一	是否符合	指标情况
最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例≥5%，或最近三年累计研发投入金额≥8,000 万元	☒ 是 ☐ 否	2022-2024 年，公司研发投入分别为 1,818.64 万元、2,994.49 万元和 5,301.86 万元，累计占比为 6.63%，最近三年研发投入金额累计超过 8,000 万元
研发人员占当年员工总数的比例≥10%	☒ 是 ☐ 否	截至 2024 年 12 月 31 日，公司研发人员占比 13.23%，超过 10%
应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利≥7 项	☒ 是 ☐ 否	截至 2024 年 12 月 31 日，公司拥有发明专利 51 项，均被应用于公司主营业务，超过 7 项
最近三年营业收入复合增长率≥25%，或最近一年营业收入金额≥3 亿元	☒ 是 ☐ 否	2024 年，公司营业收入为 63,450.10 万元，最近一年营业收入大于 3 亿元

3、公司符合国家经济发展战略和产业政策的具体情况

（1）公司主营业务符合国家经济发展战略

2024 年 7 月，中共中央《关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》在“三、健全推动经济高质量发展体制机制”中指出：要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，推动技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级，完善推动新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高

端装备、生物医药、量子科技等战略性新兴产业发展政策和治理体系；健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度，抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。

2021 年，工信部、国家发改委等八部门印发《“十四五”智能制造发展规划》的通知，通知中提出大力发展智能制造装备，加强用产学研联合创新，突破一批“卡脖子”基础零部件和装置。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提到，在高端装备制造等重点领域和关键环节部署一批重大科技攻关项目，努力攻克一批关键核心技术、“卡脖子”技术，加快关键零部件国产化替代。

公司具备坚实的研发能力，在硅、碳化硅等半导体材料的制备环节，形成了大直径单晶硅棒拉制和碳化硅气相沉积等关键材料制备技术；在硅、石英、陶瓷和碳化硅等硬脆半导体材料的高精密加工环节，形成了微深孔精密制造、曲面精加工和微深孔刻蚀等精密加工技术；在熔射再生、阳极氧化和精密清洗等表面处理环节，阶段性突破了高致密陶瓷涂层制备等表面处理技术，形成了“原材料+零部件+表面处理”一体化业务平台。公司紧扣国家科技创新发展战略，持续加大技术研发投入，提升国产零部件技术水平和产品性能，助力供应链自主可控，符合国家经济发展战略。

（2）公司主营业务符合国家产业政策

公司主营业务产品符合工业和信息化部 2023 年 12 月颁布的《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》和《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021 年版）》之先进基础材料和关键战略材料目录、国家发展和改革委员会 2023 年 12 月颁布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》和工业和信息化部、科技部、能源局和标准委 2023 年 8 月颁布的《新产业标准化领航工程实施方案（2023-2035 年）》目录。

公司主营业务产品已批量供应于逻辑类 14nm 及以下技术节点先进工艺集成电路芯片制造、存储类 200 层及以上堆叠先进工艺 3D NAND 闪存芯片制造、20nm 及以下技术节点 DRAM 先进工艺存储芯片制造等领域，处于国内领先地位；

并已在显示面板领域实现 G10.5-G11 超大世代、4.5KV-5KV 超高压工艺和 OLED 工艺制造设备中的静电卡盘以及 PVD 设备中的双极静电卡盘等关键零部件的国产替代。

（二）保荐人核查过程及意见

保荐人访谈了公司的主要管理人员，了解公司业务经营情况及技术情况；审阅了公司员工花名册及员工简历，了解公司研发人员情况；获取了公司主要采购及销售合同，了解公司客户及供应商情况，对公司主要客户与供应商进行了现场走访及视频访谈，了解交易背景及交易情况，同时履行了对主要客户、供应商进行函证的核查程序；获取了研发费用明细表，查阅了公司研发费用的归集政策，抽查了部分研发费用的会计凭证；收集并审阅了行业研究报告及竞争对手公开披露信息，了解行业信息和竞争对手业务定位。

经核查，保荐人认为臻宝科技归属于新一代信息技术产业，面向国家需求，符合国家战略，符合保荐人优先推荐科创板上市的要求。臻宝科技拥有关键核心技术，科技创新能力突出，自成立以来得到了市场的广泛认可，且具备保持持续研发创新的能力。公司主要依靠核心技术开展生产经营，且经营情况良好。臻宝科技符合科创板定位要求和国家产业政策。

四、发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件

本保荐人依据《科创板股票上市规则》相关规定，对发行人是否符合《科创板股票上市规则》规定的上市条件进行了逐项核查，具体核查意见如下：

（一）发行人符合证监会规定的发行条件

1、发行人已依据《公司法》等法律法规设立了股东大会、董事会和监事会，在董事会下设置了审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，建立了独立董事工作制度、董事会秘书工作制度，建立健全了管理、生产、销售、财务、研发等内部组织机构和相应的内部管理制度，董事、监事和高级管理人员能够依法履行职责，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见《审计报告》（天健审〔2025〕8-585号），发行人2022年度、2023年度和2024年度实现的营业收入金额分别为人民币38,561.04万元、50,635.63万元和63,450.10万元；发行人2022年度、2023年度和2024年度实现归属于母公司股东净利润分别为8,162.16万元、10,780.52万元和15,191.09万元，2022年度、2023年度和2024年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为7,786.62万元、10,351.74万元和14,519.67万元。发行人财务状况良好，营业收入和净利润表现出了较好的成长性，具有持续盈利能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

3、天健会计师审计了发行人最近三年财务会计报告，并出具了无保留意见的审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

4、根据发行人控股股东、实际控制人王兵及发行人各自出具的书面确认、网络核查结果及相关主管机关出具的证明文件，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

5、发行人符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

（二）发行后股本总额不低于人民币3000万元

发行人本次发行前股本总额为11,646.77万元，本次拟公开发行不超过3,882.26万股，发行后股份总额不超过15,529.03万元，发行后公司的股本总额不低于3,000万元，符合《科创板股票上市规则》第2.1.1条第一款第（二）项的规定。

（三）公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上

发行人本次发行前股本总额为11,646.77万元，本次拟公开发行不超过3,882.26万股，公开发行的股份达到发行后股份总数的25%以上，符合《科创板股票上市规则》第2.1.1条第一款第（三）项的规定。

（四）市值及财务指标

1、市值指标

根据《关于发行人预计市值的分析报告》，发行人预计市值不低于 10 亿元。

2、财务指标

根据天健会计师出具的《审计报告》（天健审〔2025〕8-585 号），2024 年公司实现营业收入 63,450.10 万元，扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低值为 14,519.67 万元。

3、标准适用判定

发行人结合自身状况，选择适用《科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第（一）款规定的上市标准：预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。

公司 2023 年和 2024 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 10,351.74 万元和 14,519.67 万元，2024 年的营业收入为 63,450.10 万元，按照可比同行业上市公司的估值方法预估，结合本次发行前最后一轮股权投资估值，预计公司市值不低于人民币 10 亿元。综上所述，发行人满足其所选择的上市标准。

五、对公司持续督导期间的工作安排

事项	工作安排
（一）持续督导事项	在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后三个完整会计年度内对发行人进行持续督导
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、实际控制人、其他关联机构违规占用发行人资源的制度	强化发行人严格执行中国证监会和上海证券交易所相关规定的意识，进一步完善各项管理制度和发行人的决策机制，协助发行人执行相关制度；通过《保荐及承销协议》约定确保保荐人对发行人关联交易事项的知情权，与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内部控制制度	督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合	督导发行人尽可能避免和减少关联交易，若有关的关联交易为发行人日常经营所必须或者无法避免，督导发行人按照《公

事项	工作安排
规性的制度，并对关联交易发表意见	司章程》《关联交易决策制度》等规定执行，对重大的关联交易本机构将按照公平、独立的原则发表意见
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	与发行人建立经常性信息沟通机制，督促发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露的规定
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	督导发行人按照《募集资金管理及使用制度》管理和使用募集资金；定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东大会，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	督导发行人遵守《公司章程》《对外担保制度》以及中国证监会关于对外担保行为的相关规定
7、持续关注发行人经营环境和业务状况、股权变动和管理状况、市场营销、核心技术以及财务状况	与发行人建立经常性信息沟通机制，及时获取发行人的相关信息
8、根据监管规定，在必要时对发行人进行现场检查	定期或者不定期对发行人进行回访，查阅所需的相关材料并进行实地专项核查
（二）保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	有权要求发行人按照证券发行上市保荐有关规定和保荐协议约定的方式，及时通报与保荐工作相关的信息；在持续督导期间内，保荐人有充分理由确信发行人可能存在违法违规行为以及其他不当行为的，督促发行人做出说明并限期纠正，情节严重的，向中国证监会、上海证券交易所报告；按照中国证监会、上海证券交易所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明
（三）发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定	发行人及其高管人员以及为发行人本次发行与上市提供专业服务的各中介机构及其签名人员将全力支持、配合保荐人履行保荐工作，为保荐人的保荐工作提供必要的条件和便利，亦依照法律及其它监管规则的规定，承担相应的责任；保荐人对发行人聘请的与本次发行与上市相关的中介机构及其签名人员所出具的专业意见存有疑义时，可以与该中介机构进行协商，并可要求其做出解释或者出具依据
（四）其他安排	无

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签字盖章页)

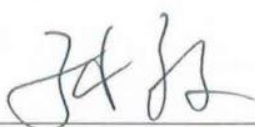
董事长、法定代表人：

张佑君



(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签字盖章页)

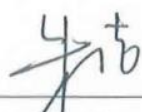
保荐业务负责人：


孙 毅



（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签字盖章页）

内核负责人：


朱洁



（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签字盖章页）

保荐代表人：

杨 腾

杨 腾

韩 潇

韩 潇

项目协办人：

栾承昊

栾承昊

